

常温接合装置

Room-Temperature Bonder

概要

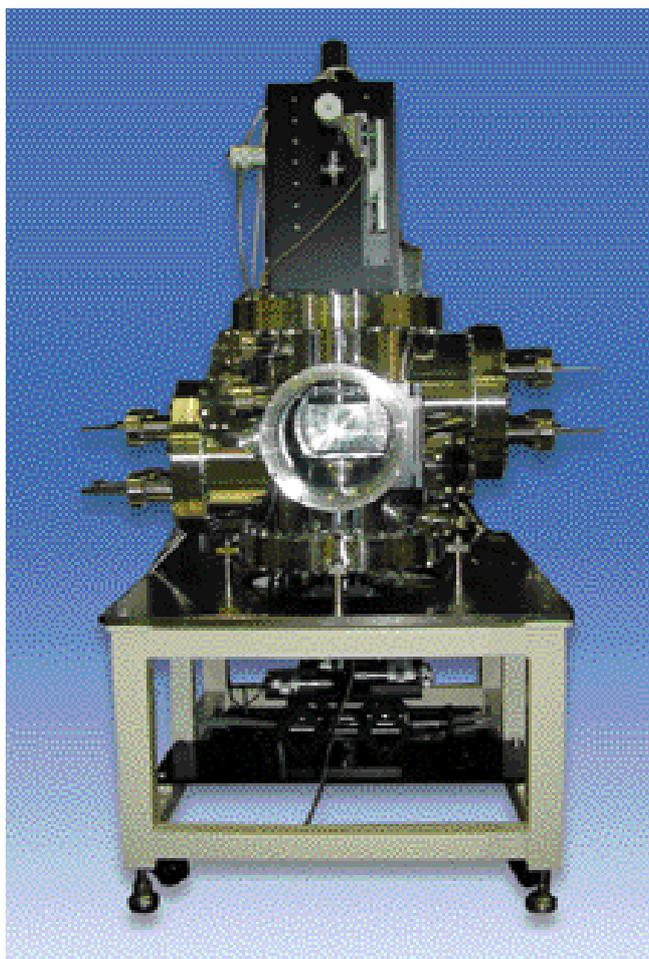
Outline

ウエハ常温接合装置は異種材料のウエハ直接接合やウエハ上に作製された微小デバイスの一括接合を行う装置です。真空チャンバー内で、2枚のウエハ表面をイオンガンによりクリーニングすることにより、常温での接合を行います。4インチまでのウエハに対応し、高精度の位置決め機能を備えています。

マイクロアセンブリ用超高真空多軸ステージは微小デバイスのチップごとの組立・実装に使用します。試料は2つの高精度の位置決めステージに装着され、任意の位置と姿勢で高精度の接合が可能です。

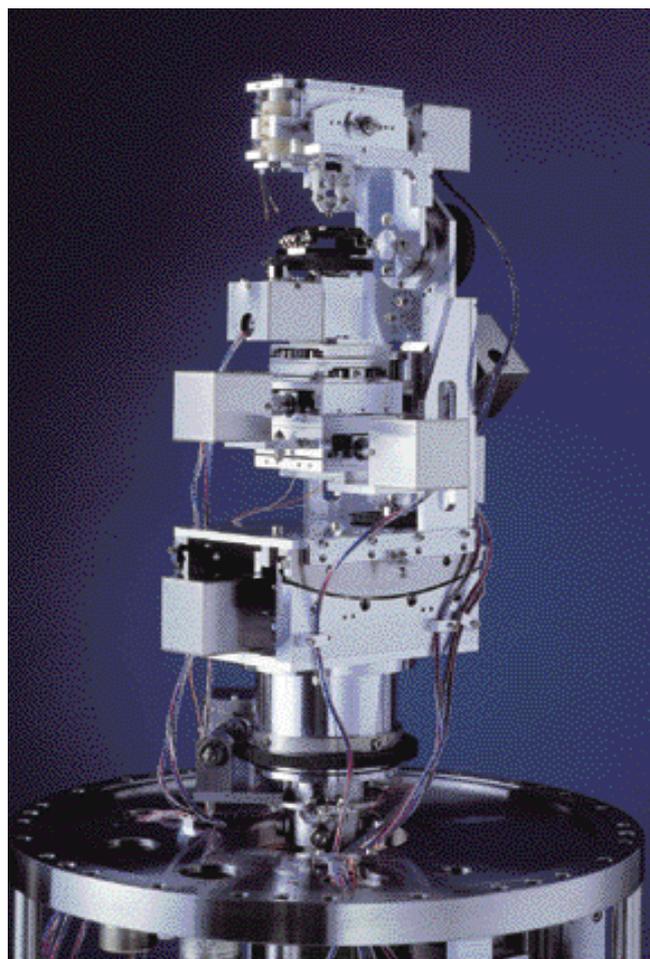
The room-temperature wafer bonder allows for batch bonding of microdevices fabricated on a wafer or a directly bonded wafer of heterogeneous materials. It cleans two wafer surfaces in a vacuum chamber using an ion gun to bond them at room temperature. Ready for wafers up to 4 inches, the bonder features high-precision positioning.

The Ultra-High Vacuum multiaxial stage for microassembly is used to assemble and mount microdevices chip by chip. Specimens mounted on a high-precision positioning stage can be bonded with high precision at any position and in any posture.



ウエハ常温接合装置

Equipment for Room Temperature Wafer Bonding



マイクロアセンブリ用超高真空用多軸ステージ

Ultra-High Vacuum Multiaxial Stage for Micro Assembly

納入先 産業技術総合研究所

Actual installation : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

納入先 東京大学先端科学技術センター 須賀研究室

Actual installation : Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo/Prof. Suga's office